

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 21 年 8 月 20 日 (2009.8.20)

【公開番号】特開 2008-34601 (P2008-34601A)

【公開日】平成 20 年 2 月 14 日 (2008.2.14)

【年通号数】公開・登録公報 2008-006

【出願番号】特願 2006-205930 (P2006-205930)

【国際特許分類】

H 0 1 L 23/50 (2006.01)

H 0 1 L 23/48 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 23/50 U

H 0 1 L 23/48 P

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 7 月 1 日 (2009.7.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

半導体素子と、前記半導体素子の裏面が表面に固着されるアイランドと、前記半導体素子と電氣的に接続されるリードと、前記半導体素子、前記アイランドおよび前記リードの前記アイランド側を一体に被覆する封止樹脂とを具備し、

前記アイランドの外周端部には、前記アイランドの表面から上方に向かって突出する突出部が設けられ、前記突出部は、前記アイランドの表面と角部を介して成る内側側面と、前記内側側面と対向して位置する外側側面と、前記内側側面と前記外側側面の間に位置する上面と、前記上面と対向して位置する下面とから成り、

前記内側側面および前記外側側面は、前記アイランドの表面に対して鋭角を成すように前記半導体素子側に傾斜している事の特徴とした半導体装置。

【請求項 2】

前記下面は、前記半導体素子の実装領域側から外側に向かって下方に傾斜している事の特徴とした請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 3】

前記リードは、前記アイランドの一側辺側に、アイランドと一体の第 1 のリードと、前記半導体素子と電氣的に接続された金属細線の接続部を有する第 2 のリードとを有する請求項 1 または請求項 2 に記載の半導体装置。

【請求項 4】

前記アイランドの一側辺と対向する他側辺側には、前記アイランドと連結部を介して一体となるタブが設けられる請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 5】

前記第 1 のリードと前記アイランドとの連続する領域および前記連結部と前記アイランドとの連続する領域には、前記突出部が省略される請求項 4 に記載の半導体装置。

【請求項 6】

前記アイランドには、前記半導体素子を固着する、実装時に半固形状または液状と成る接合材が設けられ、前記連結部の表面には、前記アイランドから前記タブ部に向かう方向と交差する方向に凹状部が設けられる請求項 4 または請求項 5 に記載の半導体装置。

【手続補正２】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】半導体装置